

2023年5月26日

## 展示会出展のお知らせ

当社は2023年5月30日（水）～6月1日（金）に中国上海市で開催される「PM CHINA 2023」に出展致します。

本展示会は PIM（パウダー・インジェクション・モールドィング）を含む粉末冶金法における世界最大規模の展示会であります。

ブースには各種セラミックス、チタン、ステンレス、耐熱合金、軟磁性材料等、加工の難しい材質の粉末射出成形品を展示し、他工法では製造が困難な材質を精密にニアネットシェイプに仕上げ、技術力の高さをアピールし新規の受注獲得に努めて参ります。

今回の展示会におきましては AIN（窒化アルミ）製放熱基板を主力展示品と位置付けております。

急速な EV 化が進む中国自動車市場に向けて必要不可欠となるセラミックス製放熱基板を展示し新規顧客の獲得を目指して参ります。

1. AIN ヒートシンク熱伝導最高値 240 W/m·k から 257 W/m·k に更新
  2. 新素材 Atect AIN を発表、熱伝導率最高値 254 W/m·k 達成
- ※通常水準は 170 W/m·k～230 W/m·k



Atect AIN 製放熱基板

以上